株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日
配当金受領株主確定日	期末配当金：3月31日 中間配当金：9月30日
単元株式数	100株
定時株主総会	毎年6月
公告方法	電子公告（https://www.fujimiinc.co.jp） ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212　東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先及び電話照会先	〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711（通話無料）

各種手続のお申出先

●支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
●住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等については、証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。
なお、証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社へお申出ください。

株式会社フジミインコーポレーテッド
お問い合わせ先：経営企画部経営企画課
TEL：052-503-8181（代表）
URL：https://www.fujimiinc.co.jp

Copyright (C) 2025 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

UD FONT by MORISAWA

FSC www.fsc.org ミックス 紙｜責任ある森林管理を支えています FSC® C013080

VEGETABLE OIL INK

この印刷物は、適切に管理された森林で生産された木材を使った環境配慮型のFSC®認証紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しております。

株式会社フジミインコーポレーテッド　株主通信

FUJIMI TODAY vol.61

2025.4.1 ～ 2025.9.30

2025年12月発行

特集

業界におけるフジミの優位性

技術を磨き、心をつなぐ FUJIMI

証券コード 5384



お客様目線の実践
パウダー＆サーフェスカンパニーへの進化
「働きがい」と「働きやすさ」の醸成
当事者意識とやり抜く力の確立
革新への挑戦

東京2025デフリンピック出場の当社所属選手3名



技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした
さまざまな産業で活かされています。
フジミはお客様にあらゆる製品を
磨いていただくことで、
人々が快適に暮らせる未来の創造に
貢献します。

代表取締役社長
関　敬史

株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

上期を振り返って

当社グループを取り巻く環境は、地政学リスクへの懸念が継続し、世界経済の不透明感が依然として残る状況でありました。ロシア・ウクライナ情勢及び中東情勢の緊張状態は継続し、加えて中国経済の成長率は緩やかに減速しました。米国の関税措置をめぐり、米国と各国との交渉や修正も繰り返されています。

世界半導体市場は、AI向け先端半導体デバイスの需要が牽引する一方で、パソコンやスマートフォン、車載向け等の需要は、底打ちの気配があるものの、本格的な回復には今しばらく時間を要すると思われます。

こうした状況下、当社においては先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向けポリシング材の販売が好調に推移したことにより、当中間連結会計期間の業績は、売上高33,496百万円（前年同期比8.9%増）、営業利益6,469百万円（前年同期比13.4%増）、経常利益6,257百万円（前年同期比11.3%増）、親会社株主に帰属する中間純利益4,671百万円（前年同期比6.9%増）となりました。

2026年3月期の見通しについて

上期においてCMP、シリコンウェハー向け製品の販売が増加したことから、通期の連結業績予想を売上高67,900百万円（前期比8.6%増）、営業利益13,000百万円（前期比10.4%増）、経常利益12,750百万円（前期比4.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益9,400百万円（前期比0.3%減）に見直しました（11月5日発表）。なお、配当は期初予想からの変更はなく、中間配当は1株36.67円とし、年間配当は1株73.34円を予定しております。

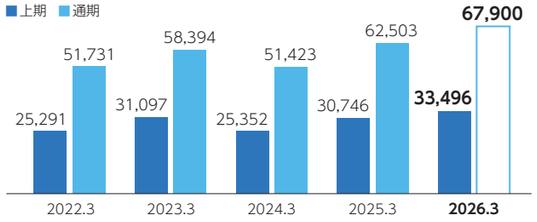
半導体市場は、中長期的には旺盛な需要が見込まれるため、当社は将来のさらなる研磨材の需要増加を見据え、積極的に研究開発や設備投資を推進しております。2025年12月末には、いよいよ岐阜県各務原市に新たな工場（名称:各務山工場）が竣工します。また、非半導体分野の新規事業の育成・探索を目的に、新たな研究開発センターも建設中です。

重ねてサステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに関わる取り組みも積極的に推し進めてまいります。

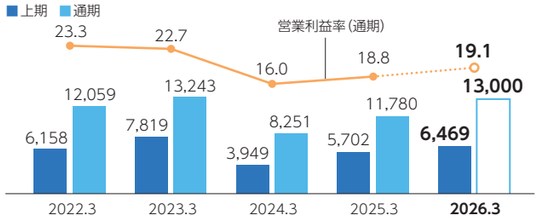
皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

連結決算ハイライト ※2026年3月期通期は予想値

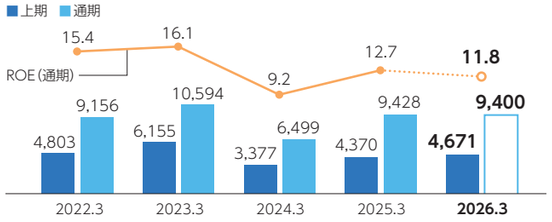
売上高（百万円）



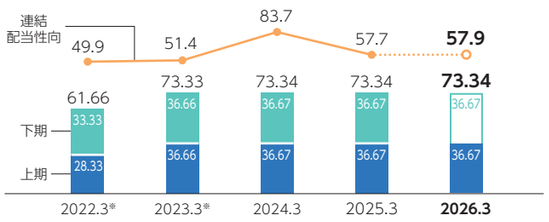
営業利益・営業利益率（百万円、%）



親会社株主に帰属する中間（当期）純利益・ROE（百万円、%）



配当金・連結配当性向（円、%）



※当社は、2023年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っております。そのため、2022年・2023年3月期の配当金については、株式分割が行われたと仮定して記載しております。
※配当金は、小数点第3位以下を切り捨てしています。

特 集

業界における フジミの優位性

今回は、業界における当社の優位性について、これまでの歩みや技術、世界シェアなどを交えご紹介します。



01 超精密研磨材のリーディングカンパニー

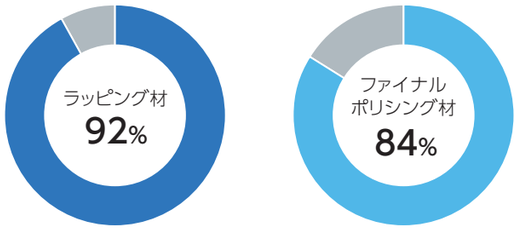
当社は1950年に、日本初の精密研磨材メーカーとして誕生以来、「研磨と言えばフジミ」との高い評価をいただいてきました。現在でも、特に半導体の製造工程で使用される超精密研磨材で高いシェアを保持しています。

当社の半導体分野への進出は1950年代に遡ります。精密研磨材の市場が主にカメラなどの光学レンズ向けであった1950年代に当社製品が高い評価を得ていたことから、1957年には電気機器メーカーからトランジスタに使用されるゲルマニウム半導体基板の研磨に関する相談を受け、当社製品の品質が最適と認められ採用されました。その後も、お客様からの研磨に関する多くのご相談に対応し、技術とノウハウを蓄積しながら、高品質な製品を安定供給してまいりました。こうしたお客様との信頼関係によって、現在では製品開発の早い段階からお声がけいただいて研磨材を提案することも多く、競合他社に先んじて市場が必要とする製品開発に取り組めていると考えています。

02 他を圧倒する高い世界シェア

当社の売上高の8割強を半導体関連が占めています。半導体は、時代とともに微細化が進み、2025年現在、先端半導体は2ナノ(ナノは10億分の1)メートル世代へ移行しています。ナノサイズの回路を形成する土台となるシリコンウェハーには汚れや欠陥のない超高精度な表面が求められます。そのシリコンウェハーの製造工程で当社のラッピング材*とポリシング材*が使用されており、世界のトップシェアを占めています。

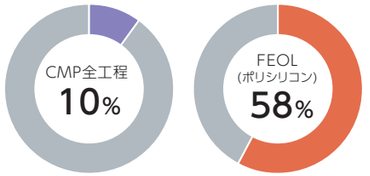
●シリコンウェハー向け研磨材の世界シェア　2025年3月 自社推計



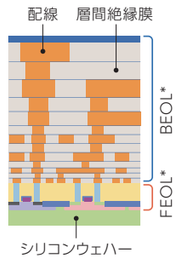
シリコンウェハー上に多層に微細な配線を施すことで、半導体デバイスウェハーは製造されますが、その配線を1層毎に研磨して平坦化する工程がCMP工程です。この工程で使用されるCMPスラリー*で、当社の世界シェアは約10%と3位グループに位置づけており、半導体の性能を左右するトランジスタ素子形成工程(FEOL)*のポリシリコン向けに限れば、世界シェアの過半を占めています。

研磨には、①平坦化(平らにする)、②平滑化(滑らかにする)、③無欠陥化(欠陥をなくす)、④汚染低減、⑤生産性の向上の要件があります。お客様である半導体メーカーでは、各社の技術ロードマップに沿って次世代から数世代先に向けた研究開発が加速しています。半導体の高性能化、高密度化、高集積化に、研磨は不可欠であり、研磨要件に大きく寄与する研磨材には、高い精度と品質、信頼性が求められます。当社は、研究開発や品質管理、生産技術力、安定した原材料の調達に至るまであらゆる側面で向上を図り、お客様に真っ先に相談され、信頼されるパートナーであり続けるよう努めてまいります。

●CMPスラリーの世界シェア
2025年3月 自社推計



●ICチップ断面



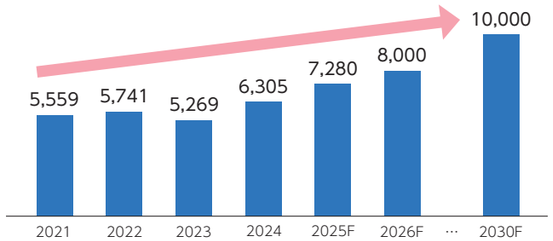
03 市場展望について

世界の半導体市場は、生成AIやデータセンター向けの需要が牽引し、2025年は前年比で15.4%増の成長が予測されています。その後も生成AI関連技術や車載用途などの需要が成長を支え、2030年には市場規模が1兆ドルに達すると見込まれています。

半導体は私たちが普段使っている多くの電子機器に使われ、日常生活や社会にとって欠かせないものです。また、AIや自動運転といった先端技術の進化にも不可欠で、現代と未来のテクノロジーを支える基盤でもあります。

昨今は地政学的な緊張を背景にサプライチェーン再編の動きが加速しており、各国は自国での半導体生産を推進しています。当社は、以前より半導体産業の集積地であるアジア・北米地域を対象に、日本・米国・台湾に製造・開発・販売機能を備えた拠点を構え、お客様の近隣で迅速かつきめ細かな対応ができる体制を整えています。

●世界半導体市場動向(年次 実績/予測)(億USドル)



2021～2026F:世界半導体市場統計(WSTS)(2025年8月発表)を基に当社でグラフ作成。
2030F:各種資料を参考に当社でグラフを作成。

●ラッピング材… シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。
●ポリシング材… ラッピング材よりもさらに細かな砥粒と薬液を配合した鏡面仕上げ用の研磨スラリー(液体研磨材)。
●スラリー…… 液体製品。
●BEOL…… Back End of Lineの略。配線工程。
●FEOL…… Front End of Lineの略。トランジスタ素子形成工程。

04 将来にわたり優位性を維持・拡大するための設備投資

お客様である半導体メーカーは、各社の技術ロードマップに沿った半導体デバイスの研究開発に莫大な費用を投下しています。当社としてもお客様のロードマップに沿った研磨材を開発するため、お客様と同等レベルの研磨装置や検査装置を導入しています。また、従業員の約3割が研究開発に関わる業務に従事し、売上高の約9%を研究開発費として継続投下しています。(P.13研究開発費・売上高比グラフ参照)

当社の製造設備はすべて自社で設計しています。各製造工程の管理を徹底し、お客様との間で培われた工程管理のノウハウを現場へ展開することで、品質や製品性能の面で確かな競争優位性を築いています。

将来の半導体需要の拡大に備え、当社の最先端製品の開発・生産・物流施設が集積する岐阜県各務原市に、新工場(各務山工場)を建設しており、まもなく竣工します。また、非半導体関連の事業領域拡大を目指し、新たな研究開発センターも建設中です。引き続き設備投資を推し進め、生産能力の増強と研究開発を加速させ、事業の拡大につなげてまいります。



岐阜県各務原市内

INFORMATION

新工場と新研究開発センターの建設状況

各務山工場

概 要	敷地面積	28千㎡
	目 的	半導体向け製品の生産能力増強
計 画	2024年10月:着工 2025年末:竣工予定 2026年中:試作品出荷予定 2027年中:本格生産開始予定	
状 況	2025年12月末に計画通り竣工予定	


完成イメージ


2025年9月29日撮影

第2研究開発センター(仮称)

概 要	敷地面積	16千㎡
	目 的	非半導体関連の研究開発、新規事業の育成・探索
計 画	2025年5月:着工 2026年後半:竣工予定	
状 況	2026年後半竣工に向けて計画通り建設中	


完成イメージ


2025年8月27日撮影

「株主様工場見学会」のご報告

会社紹介



工場説明

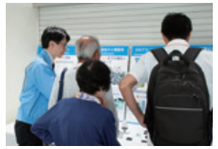


工場見学









当社へのご理解をより一層深めていただくため、「株主様工場見学会」を10月10日(金)に開催しました。当日は、社長の関によるあいさつと会社紹介のあと、国内主力工場である各務原工場の概要について説明し、シリコンウェハー向け製品のFO(粉体)とGLANZOX(スラリー)の製造・検査工程、特設展示(研磨見本や新規開発製品の紹介、Water Offset活動の動画試写、各務山工場の建設状況など)をご覧いただきました。

各務原工場



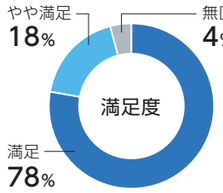
開催概要

日 時	2025年10月10日(金)
見学場所	各務原工場(岐阜県各務原市)
来場者	24名
条 件	2025年3月末時点で100株以上保有の株主様から参加希望を募り応募多数の場合には抽選
募集案内	定時株主総会決議通知に同封

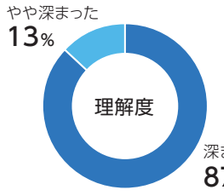
主な生産品名 | FO、GLANZOX、PLANERLITE、COMPOL、DISKLITE など

工場見学会後のアンケート集計結果のご報告

工場見学会は満足のいくものでしたか?



当社の事業内容について理解は深まりましたか?



ご参加いただきました株主様からのご意見・ご感想

- ホームページ等の画像ではなく、実際に現場を見学できて良かった。また、説明も丁寧だった。
- 展示品の見学時間がもう少し欲しい。
- 工場見学会の継続を希望。新工場(各務山工場)を見学したい。
- 今後ますますの発展を期待する。応援している。

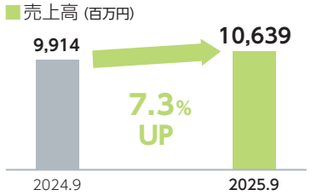
株主様から直接ご意見を伺う貴重な機会となりました。引き続き、IR活動のさらなる充実に努めてまいります。

シリコンウェハー用


シリコンウェハー

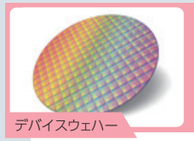
売上構成比 31.8%

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦化・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。



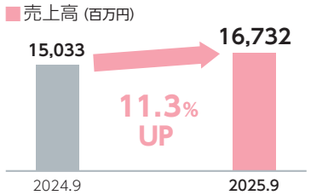
売上高はラッピング材では3,711百万円（前年同期比2.1%減）、ポリシング材では6,928百万円（前年同期比13.1%増）となりました。

CMP用


デバイスウェハー

売上構成比 50.0%

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。



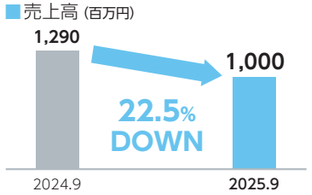
先端ロジックや先端メモリ向けの販売が増加し、売上高は16,732百万円（前年同期比11.3%増）となりました。

ディスク用


データセンター

売上構成比 3.0%

デジタルデータの記録媒体であるハードディスクドライブ用ディスク基板の製造工程に用いられる研磨材を研究開発し製造販売する事業です。



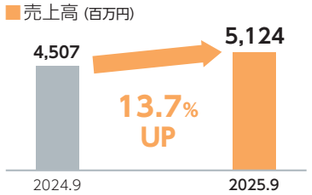
顧客の稼働は引き続き好調に推移したものの、顧客の生産プロセス改善の影響により、売上高は1,000百万円（前年同期比22.5%減）となりました。

一般工業用・その他


溶射材の主力製品 SURPREX

売上構成比 15.2%

多種多様な用途向けに研磨材や機能性材料を提供しております。また、半導体装置、航空機及び鉄鋼などさまざまな業界の溶射用途向けに溶射材を提供しております。



一般工業用研磨材につきましては、前期に子会社化した南興セラミックスの販売が加わったことなどにより、売上高は3,511百万円（前年同期比33.1%増）、その他につきましては1,612百万円（前年同期比13.7%減）となりました。

「東京2025デフリンピック」に当社所属のデフアスリート選手が出場

日本で初めて開催される、きこえない・きこえにくい人のための国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」が11月15日（土）より開幕し、11月26日（水）までの12日間行われました。本大会に出場の当社所属選手をご紹介します。

※本記事は11月4日時点の執筆です。大会結果は当社ホームページでお知らせします。

中西 椋（なかにし りょう） 選手





活動実績

- 2025ジャパンパラ陸上競技大会　男子走幅跳:1位
- 第22回日本デフ陸上競技選手権大会
  男子三段跳:1位　男子走幅跳:2位
- 第5回世界デフ陸上競技選手権大会　男子三段跳:6位

出場種目（陸上）

- 男子三段跳
- 男子走幅跳

選手コメント　皆様の応援に応えられるよう、記録もですが、勝つことにこだわり、メダルを目指します。

中村 美月（なかむら みつき） 選手





活動実績

- 2025ジャパンパラ陸上競技大会
  女子800m:1位　女子1500m:1位
- 第22回日本デフ陸上競技選手権大会
  女子800m:2位　女子1500m:2位

出場種目（陸上）

- 女子800m
- 女子1500m
- 女子4×400mリレー

選手コメント　応援してくださる皆様の期待に応えられるよう、どんな状況でも自分を信じて走ります。

吉田 琉那（よしだ るな） 選手




写真提供：第6回世界デフ水泳選手権大会実行委員会

活動実績

- 2025ジャパンパラ水泳競技大会
  女子バタフライ50m:2位、100m:2位
- 第28回日本知的障害者選手権水泳競技大会
  女子バタフライ50m:2位、100m:2位

出場種目（水泳）

- 女子50mバタフライ
- 女子100mバタフライ
- 女子100m自由形

選手コメント　応援いただきありがとうございます！大会では全力で泳ぐので、応援よろしくお願いします！

子育てサポート企業として「プラチナくるみん」認定を取得

仕事と子育ての両立支援に高い水準で取り組む企業として、2025年10月に厚生労働大臣より「プラチナくるみん」の認定を受けました。

プラチナくるみんとは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、子育てサポート企業として「くるみん認定」を受けた企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が一定の要件を満たした場合、優良な子育てサポート企業として厚生労働大臣より受けることができる特例認定です。

今後も「強く、やさしく、面白い会社」を目指し、働きがいと働きやすさを実感できる組織づくりとウェルビーイングの実現に向けて取り組んでまいります。

名古屋大学駅構内の広告看板をリニューアル

名古屋市営地下鉄名古屋大学駅の改札から2番出口へ向かう通路に、2020年12月より広告看板を掲出しています。このたび広告デザインをリニューアルしましたので、同駅をご利用の際はぜひご覧ください。



設置期間

2025年10月30日(木)～2026年10月31日(土)

名証IRエキスポ2025に出展



2025年9月5日(金)、9月6日(土)に、愛知県名古屋市の吹上ホールで開催された名証IRエキスポ2025に出展しました。

当社ブースでは、会社の概要や強み、業界・市場動向について説明しました。本イベントの来場者数は2日間で10,000名超と過去最高を記録し、当社ブースへも多くの株主・個人投資家の皆様にお越しいただきました。



石徹白での活動紹介ビデオ9作目を制作

2025年10月に、石徹白での活動紹介ビデオ9作目を当社ホームページへ掲載しました。

社員とその家族が、種子の採取から苗に育つまで大切に世話をし、石徹白地区の高畑山に植樹します。本動画では、苗になるまで育てた社員と、見守り支援した事務局の思いに焦点を当てて制作しています。ぜひ、ご覧ください。



過去の作品をはじめ、こちらからご覧いただけます。

FUJIMI INCORPORATED広報チャンネル
https://www.youtube.com/@fujimiincorporated5384

野村IR資産運用フェア2026に出展

2026年1月8日(木)～1月27日(火)、オンラインで開催される野村IR資産運用フェア2026に出展します。

この機会に当社へのご理解を深めていただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※LIVE配信期間は2026年1月8日(木)～1月10日(土)の3日間

野村IR資産運用フェアの詳細はこちらをご覧ください。

https://fair.nomura-ir.co.jp/

●野村IR資産運用フェア2026(オンライン)

当社説明会	2026年1月9日(金)18:00～18:30 オンライン出展ブースLIVE会場2

訃報

越山 勇 逝去

(元会長・社長)

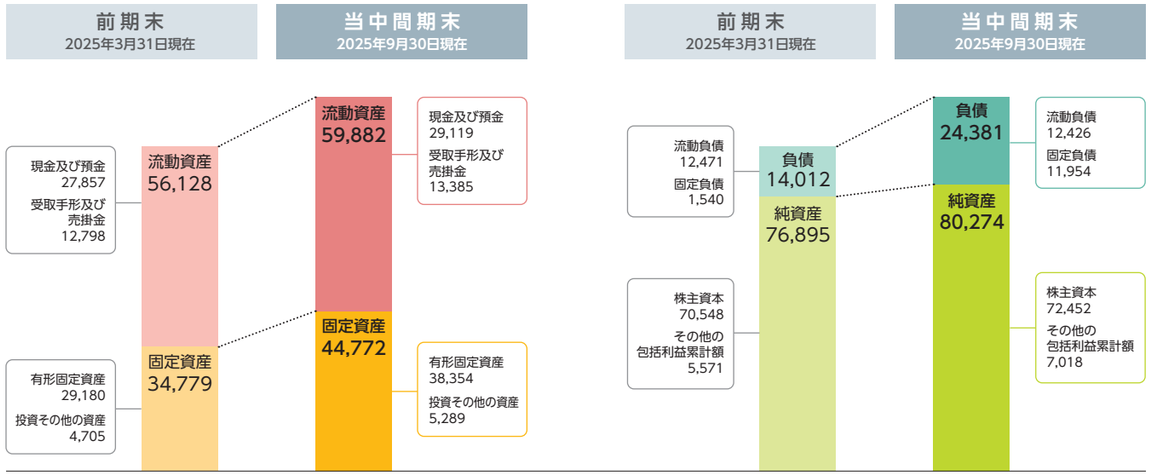
当社元会長・社長の越山勇(こしやまいさむ)が2025年10月16日に逝去いたしました(満87歳)。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます。

略歴

1964年 当社入社
1978年 取締役製造部長
1979年 取締役技術部長
1981年 代表取締役社長
1998年 代表取締役会長
2003年 退任
1996年 科学技術庁長官賞受賞
1997年 黄綬褒章受章
2005年 中部大学より工学博士号授与
2007年 アリゾナ大学より名誉科学博士号授与

連結財務諸表

連結貸借対照表の概要 (百万円)



解 説

総資産

前連結会計年度末に比べ、13,746百万円増加し、104,655百万円となりました。これは建設仮勘定が8,416百万円、流動資産その他が1,422百万円、現金及び預金が1,262百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

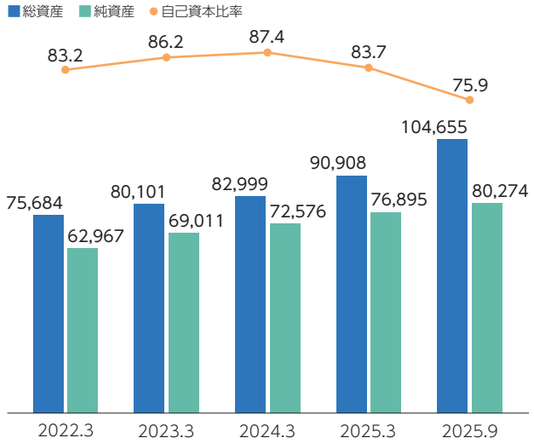
負債

前連結会計年度末に比べ、10,368百万円増加し、24,381百万円となりました。これは、長期借入金が10,000百万円増加したこと等によるものです。

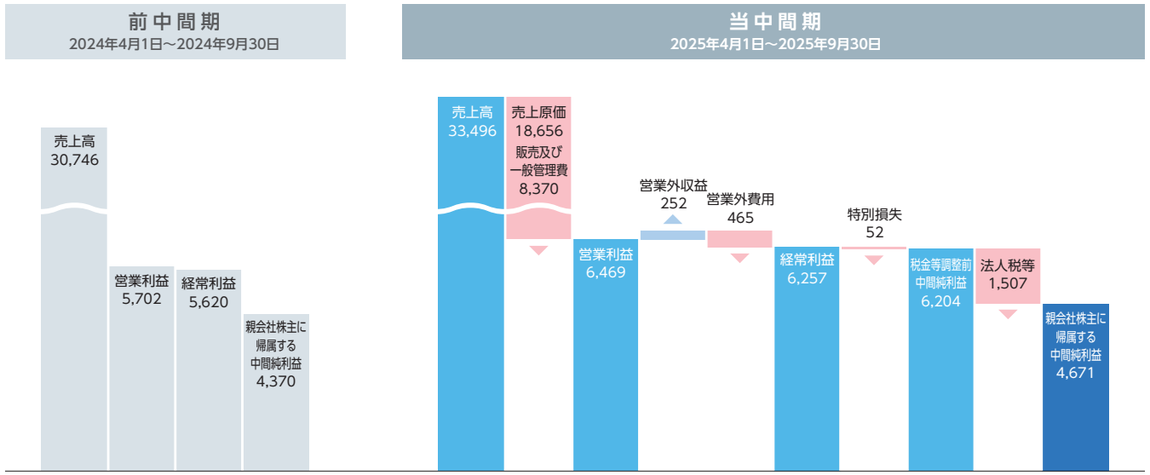
純資産

前連結会計年度末に比べ、3,378百万円増加し、80,274百万円となりました。これは、利益剰余金が1,905百万円、為替換算調整勘定が940百万円、その他有価証券評価差額金が518百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

総資産・純資産・自己資本比率 (百万円、%)



連結損益計算書の概要 (百万円)



解 説

売上高

AI向け先端半導体デバイスの需要が牽引する中、パソコンやスマートフォン、車載向け等の需要は、底打ちの気配があるものの、本格的な回復には今しばらく時間を要すると思われます。先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向けポリシング材の販売が好調に推移したことにより、売上高は前年同期比8.9％増の33,496百万円となりました。

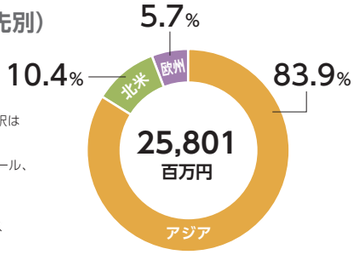
営業利益

前年同期比13.4%増の6,469百万円となりました。

親会社株主に帰属する中間純利益

前年同期比6.9%増の4,671百万円となりました。

海外売上高(仕向先別)



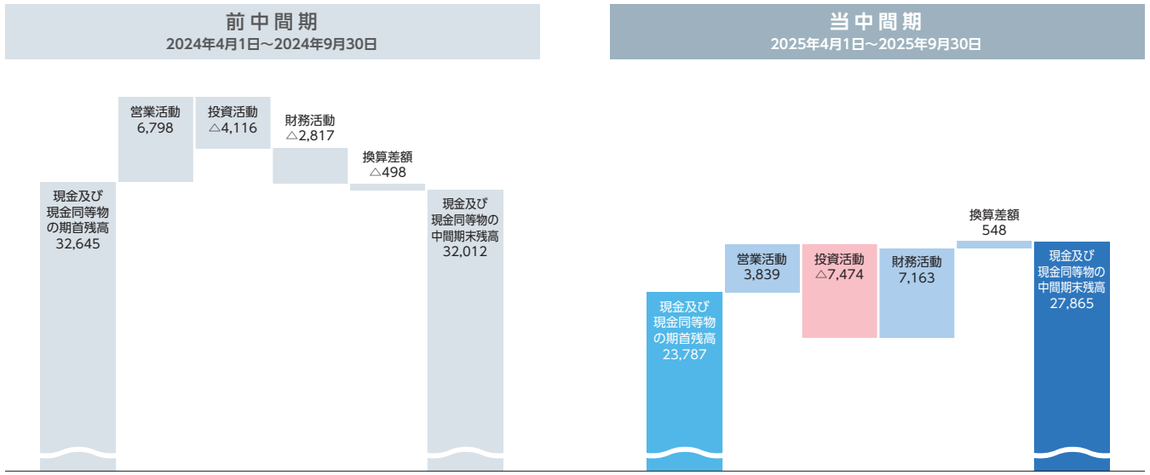
※各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりです。

- アジア：台湾、ベトナム、シンガポール、マレーシア、韓国、中国
- 北米：米国、カナダ
- 欧州：ドイツ、イタリア、イギリス

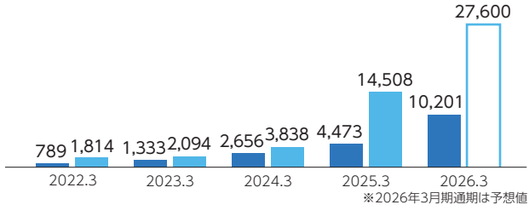
海外売上高		前中間期末 2024年4月1日～2024年9月30日	当中間期末 2025年4月1日～2025年9月30日
海外売上高	(百万円)	23,982	25,801
連結売上高	(百万円)	30,746	33,496
連結売上高に占める割合	(%)	78.0	77.0

連結財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)

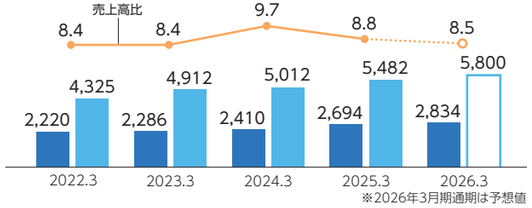


設備投資 (百万円) ■上期 ■通期



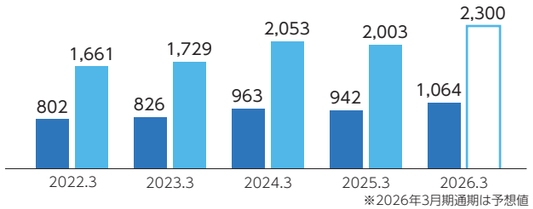
※2026年3月期通期は予想値

研究開発費・売上高比 (百万円、%) ■上期 ■通期



※2026年3月期通期は予想値

減価償却費 (百万円) ■上期 ■通期



※2026年3月期通期は予想値

利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては連結配当性向を55%以上とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、1株につき中間配当を36.67円とし、年間配当は73.34円とする予定です。

会社情報

株式情報 2025年9月30日現在

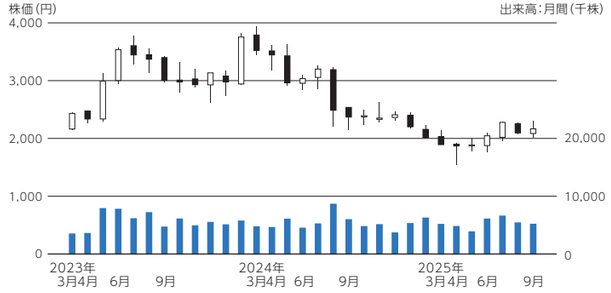
株式の状況

発行可能株式総数	320,000千株
発行済株式の総数	80,098千株
株主数	16,776名

大株主(株主名)	持株数(千株)*1	持株比率(%)*2
有限会社コマ	13,381	17.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	7,383	9.7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	4,715	6.2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4,486	5.9
フジミ取引先持株会	1,985	2.6
日本生命保険相互会社	1,918	2.5
一般財団法人越山科学技術振興財団	1,800	2.3
株式会社三菱UFJ銀行	1,530	2.0
第一生命保険株式会社	1,417	1.8
関 敬史	1,323	1.7

*1 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てしています。
*2 持株比率は、自己株式(4,646,167株)を控除して計算しております。

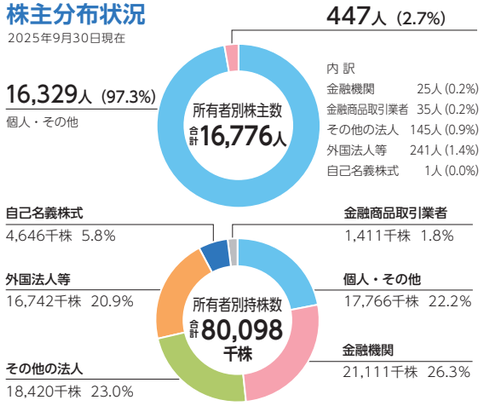
株価及び出来高の推移



(注)2023年7月1日を効力発生日として、1株につき3株の割合で株式分割を実施しており、株価は調整後株価を表示しています。

株主分布状況

2025年9月30日現在



役員

2025年9月30日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	大脇 寿樹
常務取締役	鈴木 勝弘
取締役	日比 勝之
取締役	川下 政美*
取締役	吉村 温子*
取締役	山﨑 直子*
取締役	石川 修平*
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	岡野 勝**
監査役	柴田 和範**

*印は社外取締役 **印は社外監査役

会社データ 2025年9月30日現在

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	1,281名(単体881名)